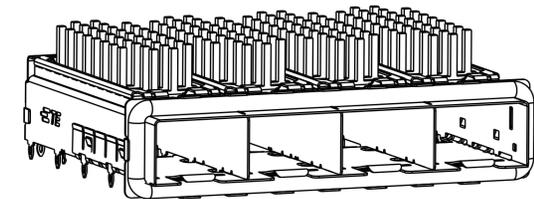


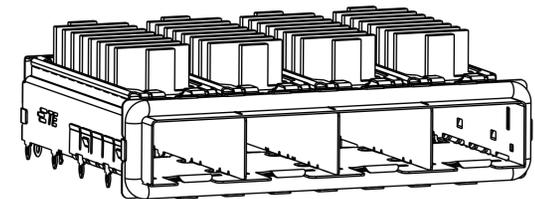
LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A		RELEASED PER ECO-12-013192	09OCT2012	BMM	MRS
		A1		RELEASED PER ECO-13-014600	20SEP2013	PP	SH
		A2		REVISED PER ECR-17-016799	01DEC2017	IT	SH



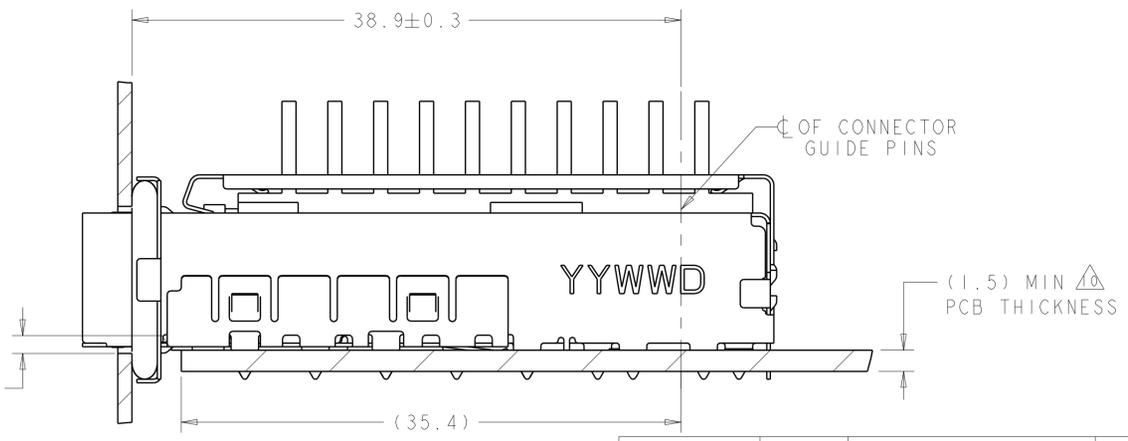
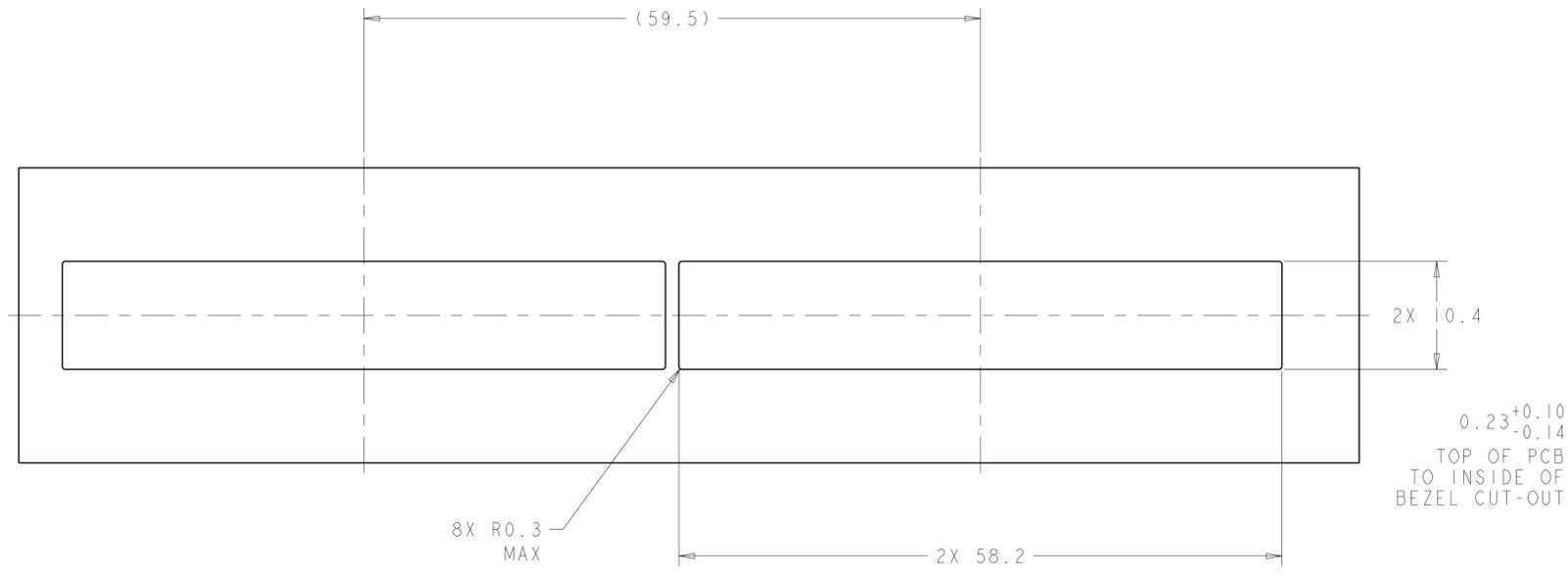
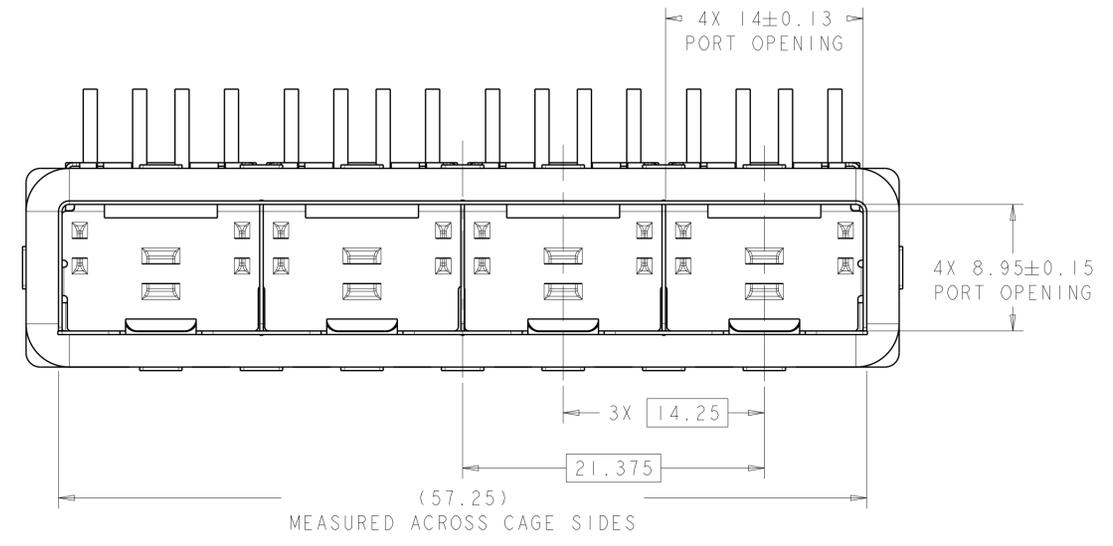
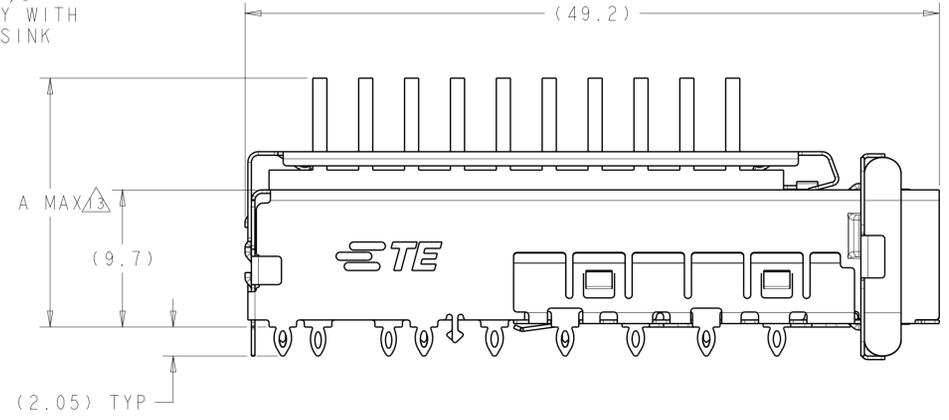
2198241-1,2,3,4
FINISHED ASSEMBLY WITH
PIN TYPE HEAT SINK

- 1 MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
GASKET RETENTION PLATE: STAINLESS STEEL
EMI GASKET: PLATED FILLED SILICONE
HEATSINK CLIP: STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINUM
- 2 FINISH:
HEATSINK: ELECTROLESS NICKEL
HEATSINK CLIP: PASSIVATE
- 3 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 4 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- 6. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OF ASME Y14.5M-1994.
- 7 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 9 HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT. SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.

- 10 MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED: 1.5mm
- 11. CERTAIN MATING TRANCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD NEED TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- 12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.
- 13 DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.



2198241-5,6,7,8
FINISHED ASSEMBLY WITH
FIN TYPE HEAT SINK



2198241
MOUNTED ON PC BOARD
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
SINGLE SIDED APPLICATIONS
SCALE 3:1

FIN TYPE	22.5	NETWORKING, TALL	2198241-8
FIN TYPE	18.1	NETWORKING, SHORT	2198241-7
FIN TYPE	15.5	SAN	2198241-6
FIN TYPE	13.2	PCI	2198241-5
PIN TYPE	22.5	NETWORKING, TALL	2198241-4
PIN TYPE	18.1	NETWORKING, SHORT	2198241-3
PIN TYPE	15.5	SAN	2198241-2
PIN TYPE	13.2	PCI	2198241-1
HEAT SINK	A MAX	APPLICATION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±0.1
1 PLC	±0.1
2 PLC	±0.1
3 PLC	±0.1
4 PLC	±0.1
ANGLES	±1°

MATERIAL:

FINISH:

Customer Drawing

DWN: B. MATTHEWS, 20OCT2011
 CHK: M. SCHMITT, 20OCT2011
 APVD: M. SCHMITT, 20OCT2011

NAME: SFP+ ENHANCED 1X4 CAGE ASSEMBLY, PRESS FIT, EMI GASKET WITH HEATSINK

PRODUCT SPEC: 108-2364
 APPLICATION SPEC: 114-13120

SIZE: A1
 CAGE CODE: 00779
 DRAWING NO: 2198241

RESTRICTED TO: -

SCALE: 6:1 SHEET: 1 OF 2 REV: A2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9